**苏州思普微电子科技有限公司网站设计**

# 网站整体架构

网站采用清晰的层级结构，主要分为首页、关于我们、业务中心、技术能力、案例展示、资质认证、联系我们七大板块，各板块相互关联，方便用户快速获取所需信息。

支持PC、移动端与PAD布局。支持中英文两种语言模式切换。

# 各板块详细内容

## 首页

* **头部区域**：左侧放置公司 logo“苏州思普微电子科技有限公司（SIPUMTECH）”，右侧设置导航菜单，包含首页、关于我们、业务中心、技术能力、案例展示、资质认证、联系我们等选项，导航菜单采用白色字体，背景为深蓝色，突出显示。
* **Banner 区域**：展示一张体现公司先进封装技术或核心业务的高清图片，图片上方叠加公司的核心宣传语 “打造卓越的先进封测及软硬件开发一站式解决方案服务商”，字体采用加粗白色，背景有半透明黑色遮罩，增强视觉效果。
* **公司简介模块**：以简洁的文字介绍公司成立时间（2019 年）、总部地点（苏州）以及公司定位（国内领先的先进系统级封装设计软硬件开发一站式服务综合服务供应商），文字下方设置 “了解更多” 按钮，点击可跳转到 “关于我们” 页面。
* **核心业务模块**：用图标搭配文字的形式展示公司的两大主营业务 —— 先进封装（设计、仿真、加工、测试一站式解决方案）和硬件方案，每个业务配一张相关的缩略图，点击可进入 “业务中心” 对应详细页面。
* **服务行业模块**：列举公司服务的行业，包括通信 / 服务器、国内外科研院所、高校、工控、医疗等，每个行业名称旁配一个简洁的行业图标，整齐排列展示。
* **底部区域**：包含公司地址（苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区 (太湖新城) 体育路 508 号金鹰商业中心 2,3 幢 3 幢 1911）、联系电话、邮箱等信息，以及版权声明 “©2025 苏州思普微电子科技有限公司 版权所有”。

## 关于我们

* **公司概述**：详细介绍公司的发展历程、企业文化、使命愿景等内容，强调公司在先进封装和硬件开发领域的决心和目标。
* **组织架构**：以树形图的形式展示公司的部门设置及各部门职责，让用户了解公司的内部管理结构。
* **团队介绍**：介绍公司的核心团队，包括硬件设计团队、SIP 设计团队、PCB 设计团队、软件开发团队、热力电仿真团队等，可配团队成员的照片和简介，突出团队的专业能力和经验。
* **团建**: 团建照片及时间

## 业务中心

* **先进封装**：
  + 晶圆级封装：详细说明提供的 wafer 后段 bump，RDL 优化及设计加工、wafer 级设计封装（WLCSP）、硅转接板、硅穿孔（TSV）设计加工、提取系统级仿真所需的芯片模型等服务内容。
  + IC 测试板设计加工：介绍 MEMS 探针卡设计加工、Load board, IC 测试板设计加工、测试 socket 代购、测试板组装等服务。
  + 先进封装一站式方案：阐述封装基板及 COB 设计与仿真、晶圆及物料代购、高密度基板加工、高密度模块封装与测试、可靠性测试及鉴定等一站式服务流程和优势。
* **软硬件方案开发**：
  + 硬件设计开发：说明硬件方案开发、原理图及 PCB 设计、板级及系统级仿真、嵌入式驱动程序及上位机软件开发、PCB 制板、元器件等服务。
  + PCB 产品：介绍高密度线卡、高频板卡、器件埋入板、电源板卡、软硬结合板、散热板等 PCB 产品，以及制板能力（层数、厚度、材料、线宽线距、最小孔径、最大铜厚等）和设计能力（工控机、射频、高速信号、存储等）。
  + 软件开发设计：详细介绍上位机软件设计、ARM 软件设计、DSP 软件设计、底层驱动设计等软件服务内容和技术特点。

## 技术能力

* **设计仿真**：包括先进封装 & SIP & 模组开发设计、仿真、基板加工、封装测试一站式解决方案，以及封装结构设计、高速 PCB 系统设计、SI PI 仿真、热、机械仿真、工艺过程仿真、DFX 检查等具体技术。
* **封装工艺**：介绍 WBBGA、FCBA、FC Bumping、TSV/WLCSP、Si Interposer、Fan-out WLP 等封装工艺的技术细节和应用场景。
* **封装基板**：说明 BT 基板、ABF 多层板、Coreless 基板、有源埋入式基板、无源埋入式基板等不同类型封装基板的特点和优势。
* **测试验证**：涵盖热、电测试、晶圆级 CP 测试、封装级 FT 测试、可靠性测试、失效分析、材料分析等测试验证技术和流程。
* **仿真能力**：详细介绍信号完整性（S 参数提取、Return Loss、Crosstalk、Insertion Loss、RLC 寄生参数提取）、电源完整性（电源 IR Drop 仿真、电源自阻抗仿真、电源纹波、电源谐振热点）、热仿真（PoP 热管理分析、SiP 结温及热阻提取、TIM 胶优化分析等）、模流仿真（流动分析、填充及金线偏移分析等）等仿真技术和能力。
* **中道晶圆级封装工艺能力**：以表格形式展示 Bumping、扇入型晶圆级封装、扇出型晶圆级封装、硅转接板 TSV Interposer、直孔晶圆级封装 Via Last TSV WLP 等工艺的具体参数和能力。
* **后道先进封装工艺能力**：介绍 80um Pitch BOT FC、Die Stack、40um Loop Height WB 等工艺，以及封测核心能力（晶圆减薄、划片能力；芯片贴装、打线能力；倒装贴片能力；Molding；细间距植球技术等）。

## 案例展示

* **先进封装案例**：
  + 某导航模组：展示板级验证、模组设计、产品设计等过程和相关图片。
  + 三维高密度通信模组：介绍原理图设计、模组设计、电热仿真、微组装、功能测试等内容，配模组结构图片。
  + 某微系统：展示微系统结构框图、基板实物图、实物封装图、封盖实物图、应用框图等，说明其组成和技术参数。
  + 舵机控制模组：介绍模组系统架构、技术参数（BOM、封装形式、模组尺寸、温度范围等），配相关图片。
  + 飞控模组：展示模组系统架构、技术参数，配相关图片。
  + 陶瓷模组：展示陶瓷基板设计、陶瓷基板封装等图片和相关信息。
* **合作伙伴**：
  + 展示合作伙伴的logo

## 资质认证

* 展示公司获得的质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016 idt IS09001:2015）和武器装备质量管理体系认证证书（GJB 9001C-2017 标准），包括证书编号、覆盖范围、发证日期、有效期等信息，可提供证书图片供用户查看。提供查询的网站链接。

## 联系我们

* **公司地址**：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区 (太湖新城) 体育路 508 号金鹰商业中心 2,3 幢 3 幢 1911。
* **联系电话**：15318923490
* **邮箱**：wenqiang.chang@sipumtech.com
* **联系表单**：设置在线联系表单，用户可填写姓名、电话、邮箱、留言内容等信息，提交后公司相关人员会及时回复。
* **地图导航**：嵌入百度地图或高德地图，标注公司位置，方便用户查找。